

# ビルドアッププリント配線板 (PPBU®)

<https://www.cmk-corp.com>

## 特長 Features

- ビルドアップ層にプリプレグを採用、薄型でも高い剛性を実現(薄いコアを用いた多段ビルドアップにも最適です)。
- 優れた絶縁信頼性・寸法安定性・実装安定性(低たわみ)。
- 0.4mmの狭ピッチBGA/CSP実装に対応(ランド径:200um)。
- インピーダンスコントロールにも対応。
- ハロゲンフリー材の採用、Pbフリー実装にも対応可能です。

- Even thin type PWB, keeps high rigidity by using prepreg for every build-up layer (Suitable for multi layer HDI with thin core)
- Excellent insulation reliability, dimensional stability and mounting stability.
- Applicable for 0.4mm pitch BGA/CSP mounting. (Land dia. : 200um).
- Applicable for impedance control.
- Able to use halogen-free material and adopt Pb-free mounting

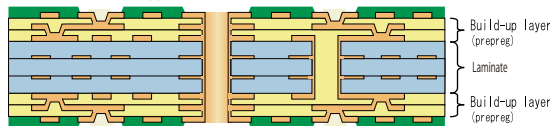
## 用途 Application

- エンジンコントロールをはじめとする各種車載機器にも適します。
- エニージェット構造も可能で、スマートフォン向けに最適です。

- Suit for automotive appliance such as ECU.
- Any-Layer structure is available. Suitable for smart phone.

## 構造 Structure

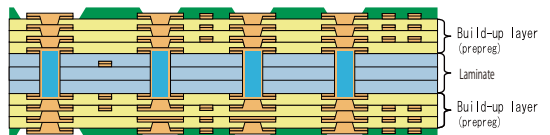
Ver. I ( 8 layer staggered model )



Structure



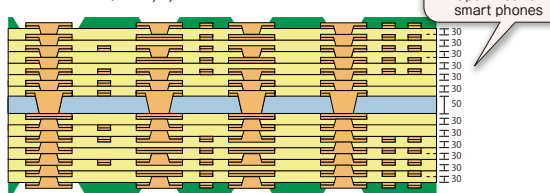
Ver. II ( 10 layer full stacked model )



Stacked Via structure



Ver. III ( 14 layer Any-layer model )



Structure



スマートフォン向けに最適  
Optimized for smart phones

## 生産拠点 Production locations



## 量産対応可能なPPBU仕様

## HDI specifications that can be mass-produced

Factory	現在 The present		2022年以降 Expected after 2022	
	現在	The present	2022年以降	Expected after 2022
日本国内 (CMK JAPAN)	Ver. I (Staggered Model)			
	Ver. II (Full Stacked Model)			
	Ver. III (Any-Layer Model)			
希門凱電子 (CMK WUXI)	Ver. I (Staggered Model)			
	Ver. II (Full Stacked Model)			
	Ver. III (Any-Layer Model)			
CMKタイ (CMK THAILAND)	Ver. I (Staggered Model)			
	Ver. II (Full Stacked Model)			
				Ver. III (Any-Layer Model)

